

第 18 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 29 年 7 月 10 日(月) 10:30~16:20

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室 (東京都中央区)

時 間	題 目	講 演 者
10:30~ 12:00	司会 山内 啓(群馬工業高等専門学校)	
	『電子機器への環境リスク~はんだフラックスの影響~』 (45 分)	○斎藤 彰((株)村田製作所)
	『最新動向レーザーはんだ付けと開発テーマ(仮)』 (45 分)	占部 亨史、○河野 寛史 ((株)ジャパンユニックス)
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	委 員 会 議 事	
13:10~ 14:40	司会 出田 吾朗(三菱電機(株))	
	『プリントドエレクトロニクスによるGaN系LED基板への常圧電極形成』 (45 分)	○柏木 行康、斎藤 大志、千金 正也 (大阪産業技術研究所)
	『鉛フリーはんだの粘度測定における現状と課題について』 (45 分)	○橋本 康孝、太田 弘道、西 剛史 (茨城大学)
14:40~ 14:50	休 憩	
14:50~ 16:20	司会 松岡 洋(日本電気(株))	
	『表面実装型パワー半導体における熱伝導冷却技術の開発』 (45 分)	○藤井 健太、佐藤 翔太、白形 雄二、 中島 浩二、熊谷 隆、大川 太 (三菱電機(株))
	『パワーモジュール向け無電解ニッケルめっき液の開発』 (45 分)	○橋爪 佳(奥野製薬工業(株))

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。